

股票代號:3135



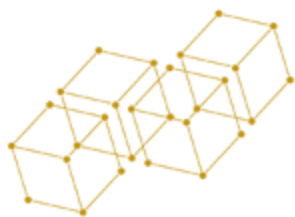
凌航科技股份有限公司

GOLDKEY TECHNOLOGY CORP.

2026年第二季法人說明會

2026/06/11

- 本簡報中之任何意見與資訊，係基於公開資訊觀測站上對外揭露之相關資訊，如有所變更，請詳對外揭露公告資訊，本公司不再另行通知。本公司並無義務更新或維護本簡報中所含任何資訊。本公司對於本簡報之內容與資訊，不作任何明示或暗示。對於本簡報內容與資訊之準確性或完整性，係依照對外公告披露資訊進行編製，本公司均不對使用本簡報內容所致任何損害負任何責任。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或修正之責任。同時不涉及任何財務及營運數字的預估及假設。



專注記憶體應用開發，構建穩健成長基石



創立與里程碑

1998年 成立

台灣 SIM Card IC 市占率 > 50%

2007年 轉型

記憶體產業經驗超過25年



財務穩健度

NT\$ 9 億

實收資本額，結構穩定健全



核心產品佈局

記憶體方案開發與銷售

DRAM IC、NAND FLASH IC、
DRAM Module、SSD



經營與據點

曾珍

董事長暨總經理

企業總部

新北市

2025 年 營 收

77 億

新台幣

2025 EPS

6.33

新台幣 元

營 收 成 長 Y o Y (2 0 2 2 - 2 0 2 5)

2022 → 23

+19%

2023 → 24

+29%

2024 → 25

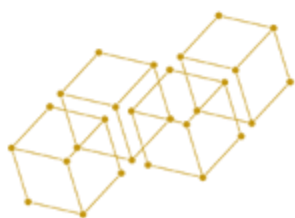
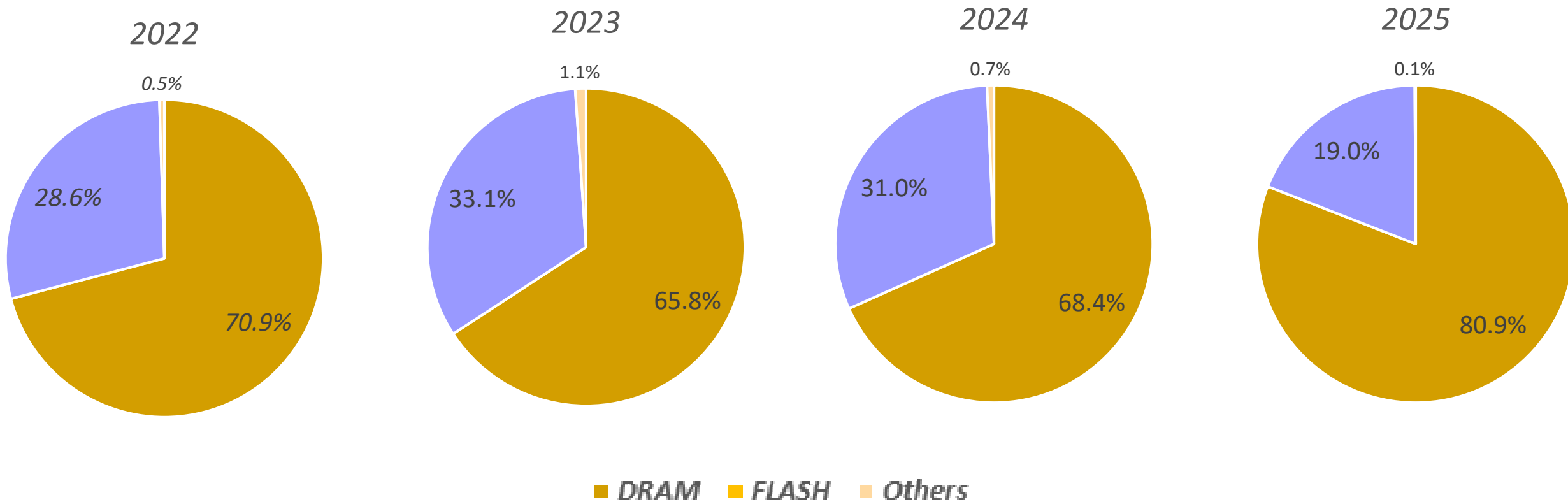
+40%



轉型期 記憶體業務	1998	凌航科技股份有限公司正式成立；深耕台灣 SIM Card IC 市場，市占率逾 50%
	2007	引進新經營團隊，全面切入 DRAM 動態隨機存取記憶體產業
	2009	完成股權移轉及組織重組；導入超頻記憶體產品；開拓嵌入式記憶體應用市場；連續榮獲經濟部國貿局優良出口商獎
扎根期 SI 高端超頻	2010	取得國際一線大廠長期代工合約，奠定全球供應鏈地位
	2012-2017	打入中南美洲系統整合市場（2012）；進軍國際 SI 通路（2015）；推出 Neo Forza 高端超頻電競品牌並參與全球重要展會（2017）
全面發展期 AI 工控市場	2020-2021	導入 ECC 工業級記憶體方案並完成認證；率先採用先進製程 DDR5；全面切入工控產品應用市場；榮獲前十大主晶片廠 AVL 認證（嵌入式記憶體方案）
	2022	量產寬溫 -55~105°C DRAM/FLASH 工業級產品；推出 DDR5 6400MHz 超頻電競 RGB 記憶體；完成伺服器記憶體認證；榮獲中華徵信所台灣 TOP 5000 電腦組件業第 17 名
	2023	與歐洲夥伴合作工業物聯網技術解決方案；榮獲天下雜誌「前 1,000 大製造業」殊榮；取得印度政府電子白板及筆電採購專案
	2024	購置公司自有總部；榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業類獎」暨全國首獎；完成低功耗記憶體晶片方案認證；正式導入台灣系統品牌大廠供應鏈
IPO 上市 AI 應用起飛	2025	IPO 八月掛牌上市；因應全球記憶體需求爆發，持續作為長期策略客戶之穩定供貨首選
	2026	展望 推出"記憶體+儲存"全方位解決方案，深化 AI、網通、Edge、機器人、車載、代理式AI、醫療市場布局

無縫串聯上游原物料與下游高成長AI/Edge應用，扮演核心關鍵樞紐角色





提供客戶一站式 (One-Stop Shopping) 採購服務



R&D研發實力

AI與邊緣運算記憶體相關研發，如：散熱、能效等，將決定未來技術訂價權的領先幅度。



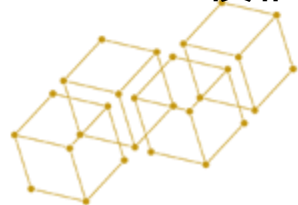
非消費級營收結構

提升工控、AI邊緣運算、車載、機器人、智慧醫療等高毛利營收比重，與景氣循環週期報價脫鉤。



供應鏈保障能力

記憶體上游原廠長期供貨配合及取得高規顆粒的能力，確保穩定交貨的核心競爭力。



傳統記憶體模組模式

核心定位

買顆粒、PCB 打件代工。

交付價值

單純提供「儲存空間」與標準規格。

獲利特徵

低毛利、高度依賴報價循環。

護城河

規模經濟與採購成本控制。

凌航核心價值

核心定位

以「技術密集」為核心的「服務業」。

交付價值

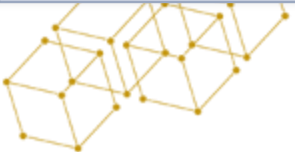
提供穩定的「技術」與「系統」解決方案。

獲利特徵

提升非消費性營收、抗週期、穩定現金流。

護城河

軟硬體整合能力與路徑工程技術。



凌航為邊緣計算應用與AI 基礎設施供應商



SoC/Embedded 內嵌利基型

Industrial 工控

Gaming 超頻電競



2017

Neo Forza Gaming brand
DDR4 Faye/Encke/Finlay 3600
MARS RGB DDR4 3600

2019

DDR4 4000MHz
PCIe Gen3*4 4CH SSD

2021

DDR4 5000MHz
DDR5 6400MHz

2024

DDR5 8200MHz Trinity
DDR4 RDIMM -40~85 °C
PCIe Gen4*4 High speed SSD

2025

DDR5CMM2
LPCMM2
CKD DIMM

2026

CQDIMM
DDR5 Server DIMM
PCIe Gen5 eSSD

應用領域

AI PC / NB

工控

AI 運算

DRAM

- ◆ 標準型 DDR4/DDR5 UDIMM/SODIMM/ CKD DIMM
- ◆ 超頻 DDR4/DDR5 UDIMM/RGB
- ◆ DDR5 LPCAMM2
- ◆ CQDIMM

容量：8GB – 128GB
速率：3200 – 8533 MT/s



- ◆ 寬溫 DDR4/DDR5 SODIMM
- ◆ 寬溫 DDR4/DDR5 U-DIMM
- ◆ 寬溫 ECC UDIMM/ SODIMM

容量：8GB – 64GB
速率：3200 – 6400 MT/s
操作溫度：-40°C ~ 85°C



- ◆ DDR5 RDIMM (Xeon / EPYC)
- ◆ CKD DIMM
- ◆ DDR5 CAMM2/ LPCAMM2
- ◆ SOCAMM2

容量：16GB – 64GB per DIMM
速率：4800 – 6400 MT/s



FLASH

- ◆ M.2 NVMe SSD (PCIe Gen3/4/5)
- ◆ M.2 SATA SSD

容量：256GB – 4TB
介面：PCIe Gen3 / Gen4 / Gen5



- ◆ 工規 mSATA
- ◆ eMMC 5.1
- ◆ 工業 M.2 SSD/2.5" SATA
- ◆ 工業 M.2 NVMe SSD
- ◆ USB Flash / SD/Micro SD Card

容量：8GB – 2TB
Flash mode: SLC /MLC/TLC/ pSLC
操作溫度: (CT/ET/WT)



- ◆ PCIe Gen4 / Gen5 NVMe eSSD
- ◆ 2.5" SATA -Boot SSD (伺服器 OS 啟動碟)

容量：960GB – 15.36TB
介面：SATA/PCIe Gen4 / Gen5
Form factor: U.2/ E1.S/E3.S/2.5"





Embedded Memory

Product:

- DDR5/4 /3 UDIMM
- DDR5/4 /3 SODIMM
- DDR5/4 /3 Very Low-profile

Feature:

- Using only the highest quality Original IC
- Industry-first Dram IC
- Customized Memory

Edge AI Memory

Product:

- DDR5 CUDIMM
- DDR5 CSODIMM
- LPCAMM2
- DDR5 CAMM2

Feature:

- Using only the highest quality Original IC

Server Memory

Product:

- DDR5/4 RDIMM
- DDR5/4 ECC DIMM
- DDR4 ECC Low-profile
- DDR4 Mini DIMM

Features:

- Implemented ECC function
- Stringently tested with the in-house

Extreme Environment Memory

Product:

- DDR4 WT DIMM

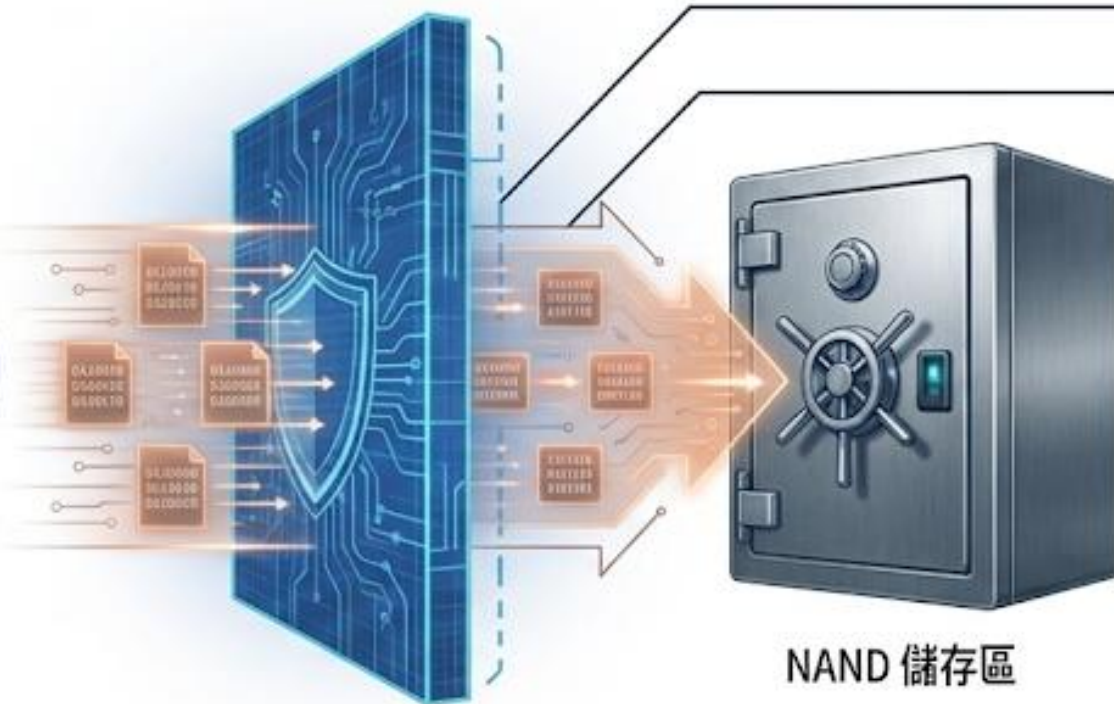
- Gold finger 30μ"
- Wide temp.



Firmware as a Firewall



異常斷電
(Power Loss)



韌體調度與防護層
(Firmware Shield)

NAND 儲存區

斷電保護 (PLP)

在異常斷電瞬間，透過鉭質電容與韌體精準調度，確保傳輸中的資料完整寫入，避免系統崩潰與資料毀損。

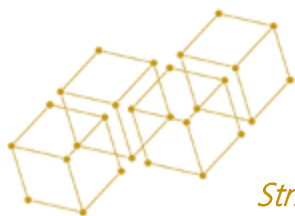
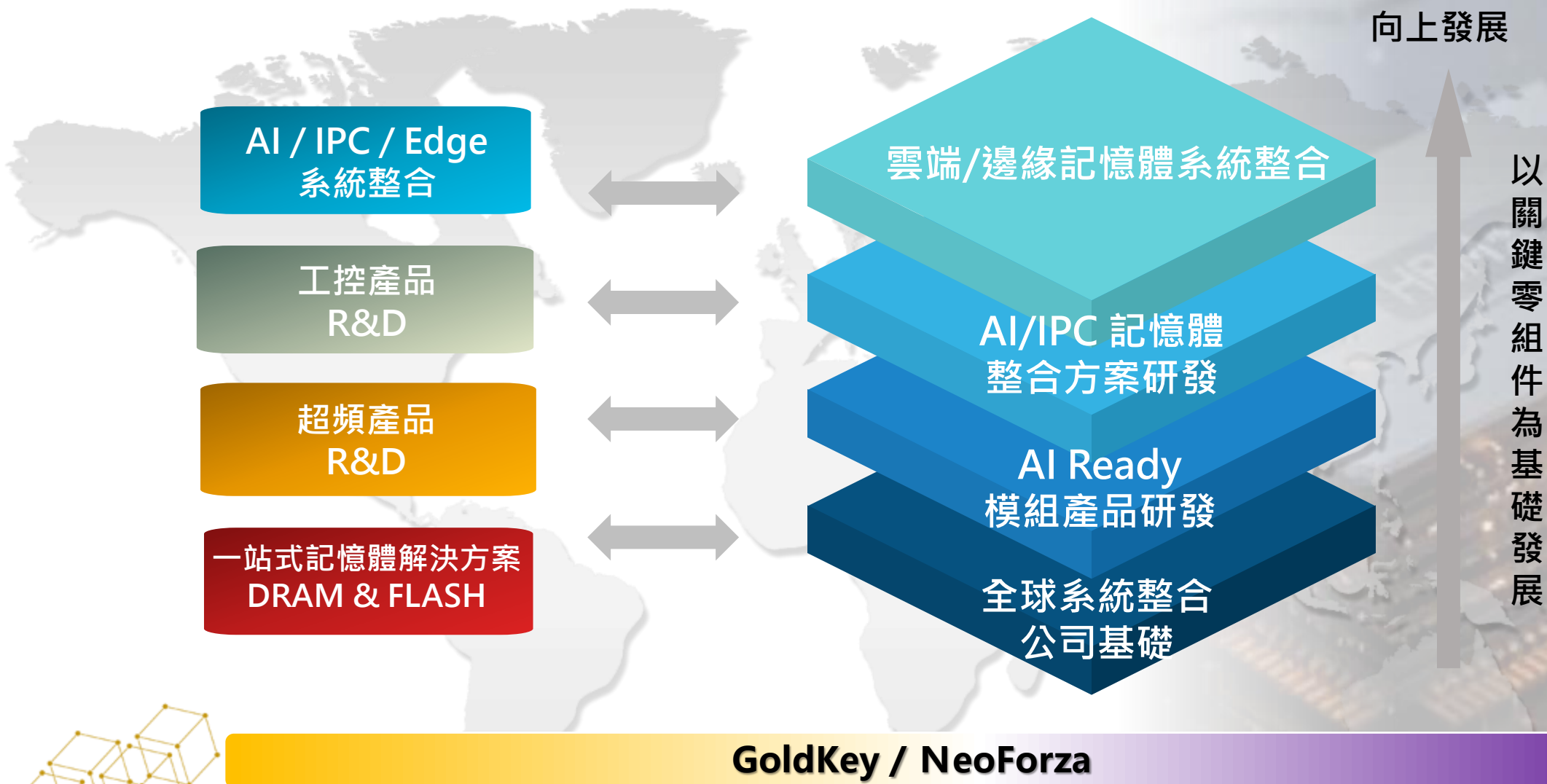
資料加密 (SED)

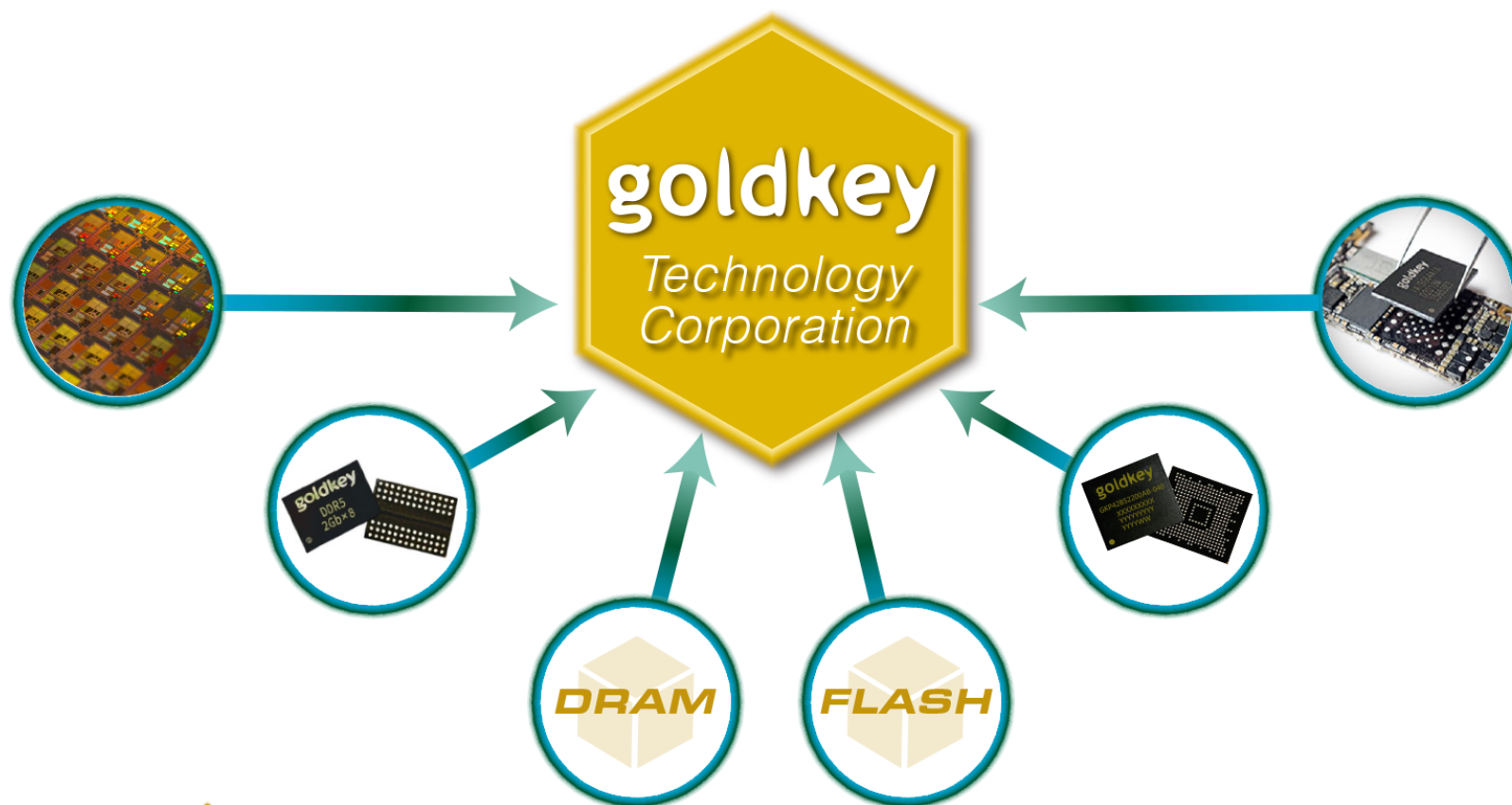
硬體級別的即時加密防護，滿足國防、醫療與高階伺服器對資安的嚴苛合規要求。

磨損均衡 (Wear-leveling)

透過進階演算法平均分配寫入次數，極大化延長工控設備在惡劣環境下的使用壽命。







上游物料供應優勢+中游技術加值的整合方案商



核心戰場

工業控制

Industrial / IPC

- 抗硫化、寬溫、抗震嚴苛認證，凌航已具備完整驗證能力
- 通過多項工業認證，提供寬溫、抗硫化、長壽命模組，具備完整驗證能力
- 透過 Design-in 綁定機制深耕策略客戶，長效供貨承諾建立不受報價波動影響的穩定現金流

**2026-2030
產業 CAGR
7.9%**



新興機會

邊緣運算

Edge AI / Embedded

- 原廠資源集中 HBM，標準型利基市場出現供給真空
- 客製化設計能力強，可針對嵌入式場景提供低功耗、長效供貨保證的專屬模組方案
- 提前卡位工業 4.0 與智慧製造浪潮，填補標準型利基市場的供給真空

**2026-2030
產業 CAGR
17.6%**



高成長

機器人/物理AI

Robot/ Physical AI

- 物理 AI 對記憶體低延遲、高可靠度要求嚴格，且隨推論運算需求上升，邊緣記憶體用量大幅成長
- 客製化模組精準對接機器人控制器與 AI 推論加速器需求
- 透過 Design-in 機制深化與機器人廠商合作，提前卡位 AI 邊緣運算關鍵供應鏈

**2026-2030
產業 CAGR
47.2%**



高門檻

車載電子

Automotive

- 電動車與 ADAS 快速發展帶動車用記憶體需求大幅提升，車規認證形成高競爭壁壘
- 具備車規認證驗證能力，提供符合汽車標準的高可靠度車用記憶體模組
- 積極切入 Tier 1 客戶認證流程，建立長期穩定訂單能見度

**2026-2030
產業 CAGR
31.7%**



高壁壘

智慧醫療

Medical

- 醫療設備對資料完整性、斷電保護及資安合規要求極高，法規認證壁壘使客戶黏著度極強
- PLP斷電保護技術直接對應醫療設備需求，SED 加密能力滿足嚴苛資安合規要求
- 聚焦通過醫療法規認證客戶，以高門檻產品建立難以被取代的長期供應關係

**2026-2030
產業 CAGR
7.7%**

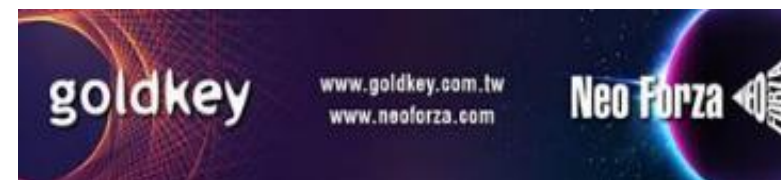
Source: Goldkey內部整理



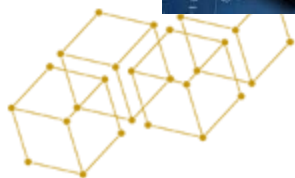
1：聚焦 Edge + 工控終端應用



2：AI運算 DRAM / eSSD



3：財務結構與庫存策略最佳化



E / 綠色承諾

綠色製程

- ✓ 產品製造符合RoHS(有害物質限用指令)，保護環境
- ✓ 原材料選用綠色電子產品認證
- ✓ 優化生產流程，延長產品生命週期，減少能源消耗

友愛環境

- ✓ 電子簽呈、線上會議，邁向無紙化
- ✓ 發起愛地球志工日，一同淨灘
- ✓ 使用環保餐具，落實垃圾分類



S / 回饋送愛

捐贈物資

- ✓ 定期捐贈記憶體產品、愛心捐款，回饋社會並推動數位、資訊教育
- ✓ 贊助體育署推動體育運動發展
- ✓ 關懷獨居老人、親送物資

支持公益

- ✓ 購買公益團體產品，支持弱勢團體自我實現



G / 誠信透明

董事會職能

- ✓ 四席獨立董事，達董事會成員二分之一
- ✓ 董事會成員多元化(專業及性別平等)
- ✓ 審計委員會，事前審核職權更全面
- ✓ 設置公司治理主管

營運透明

- ✓ 官網設置投資人專區
- ✓ 即時公開重大資訊

利害關係人溝通

- ✓ 設有專屬聯繫管道

永續治理

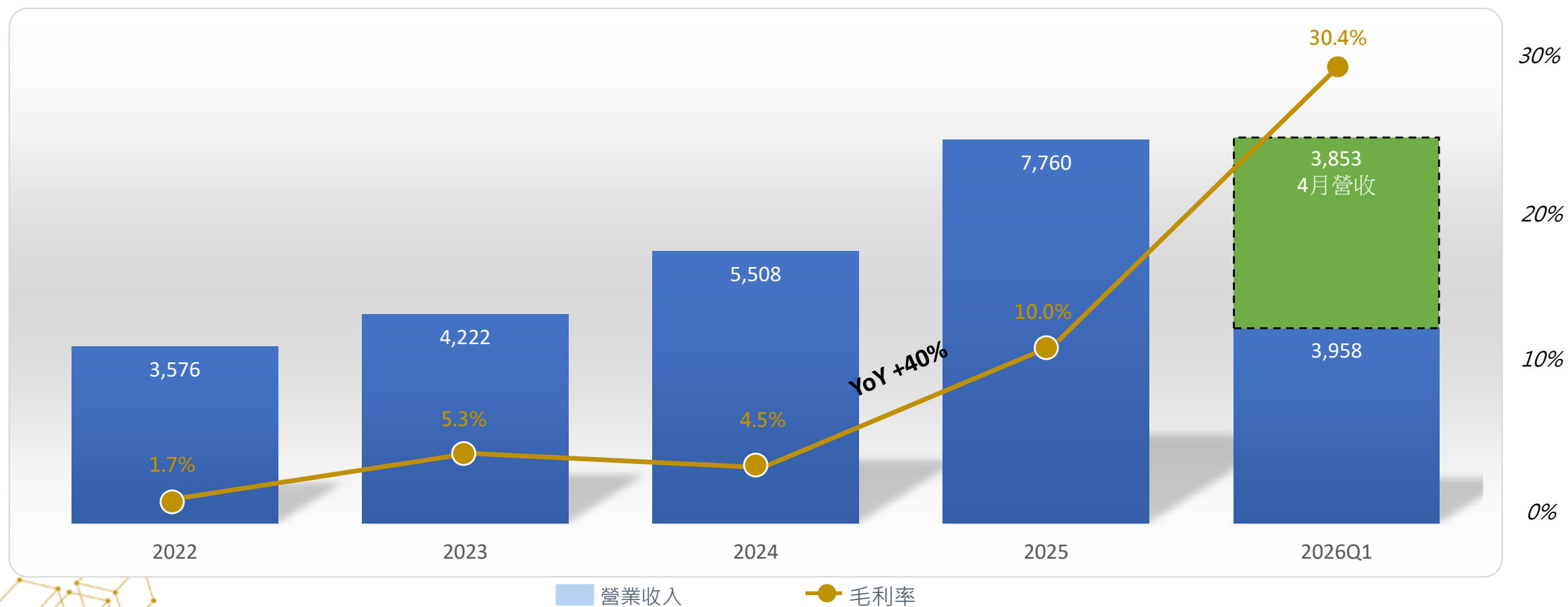
- ✓ 落實內稽內控



財務資訊

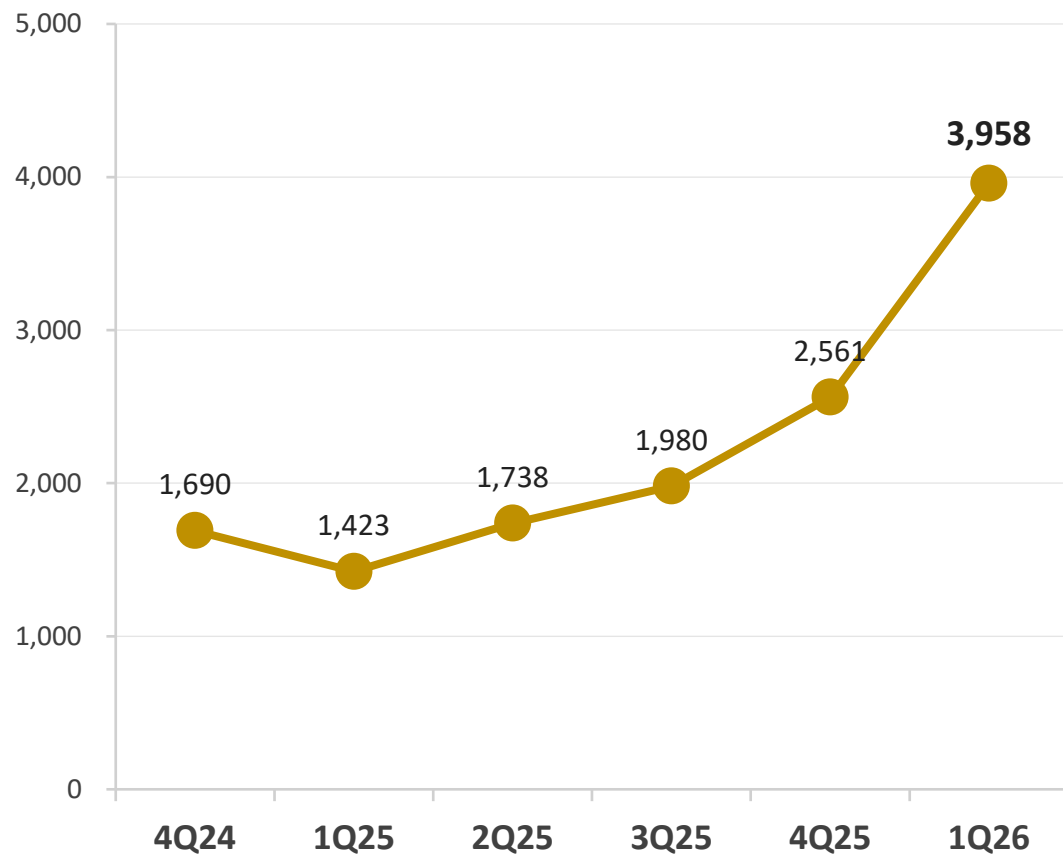
Financial Highlights

單位：新台幣百萬元



2025 營收YoY成長 40%，1Q26 毛利率創歷史新高

單位：新台幣百萬元



營收動能爆發

- Q1 累計營收 39.58 億
- 年增率達 177.96%

獲利強勢成長

- 2025 全年 EPS 6.33 元 (年增 167%)
- 1Q26 單季 EPS 10.76 元 (季增 120%、年增 1,893%)

毛利結構改善

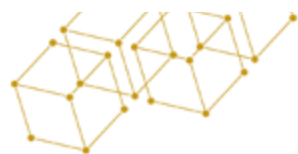
- 記憶體產品ASP上升貢獻
- 非消費性營收占比持續提升

資金彈性強化

- 發行可轉換公司債，主動強化資產彈性
- 資金策略性配置於庫存優化，支撐中長期成長動能

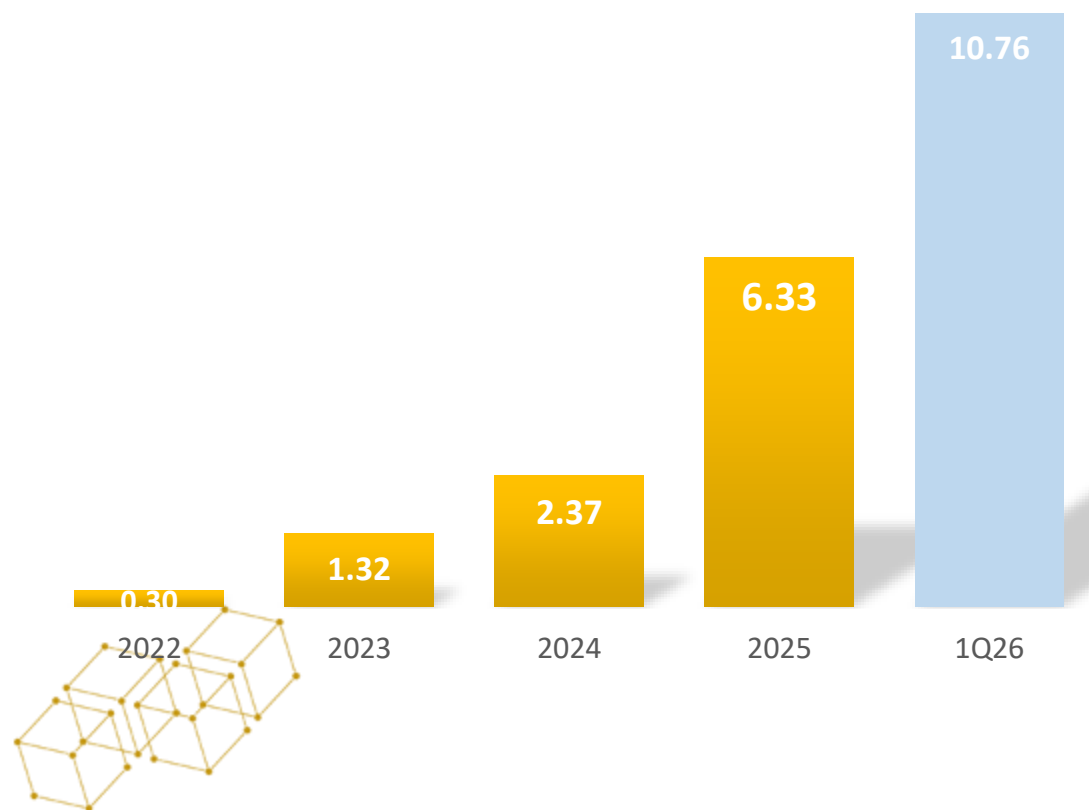
股東回饋穩健

- 維持高配發比率，利潤與股東共享
- 持續秉持穩健股利政策



近年度 EPS 表現

(單位：新台幣元)



關鍵獲利指標

6.33 元

2025 全年 EPS

Annual EPS

4.83 元

25Q4 單季 EPS

Q4 Quarterly EPS

77 %

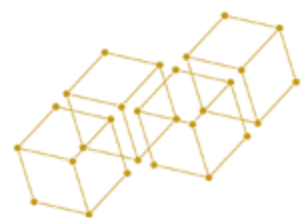
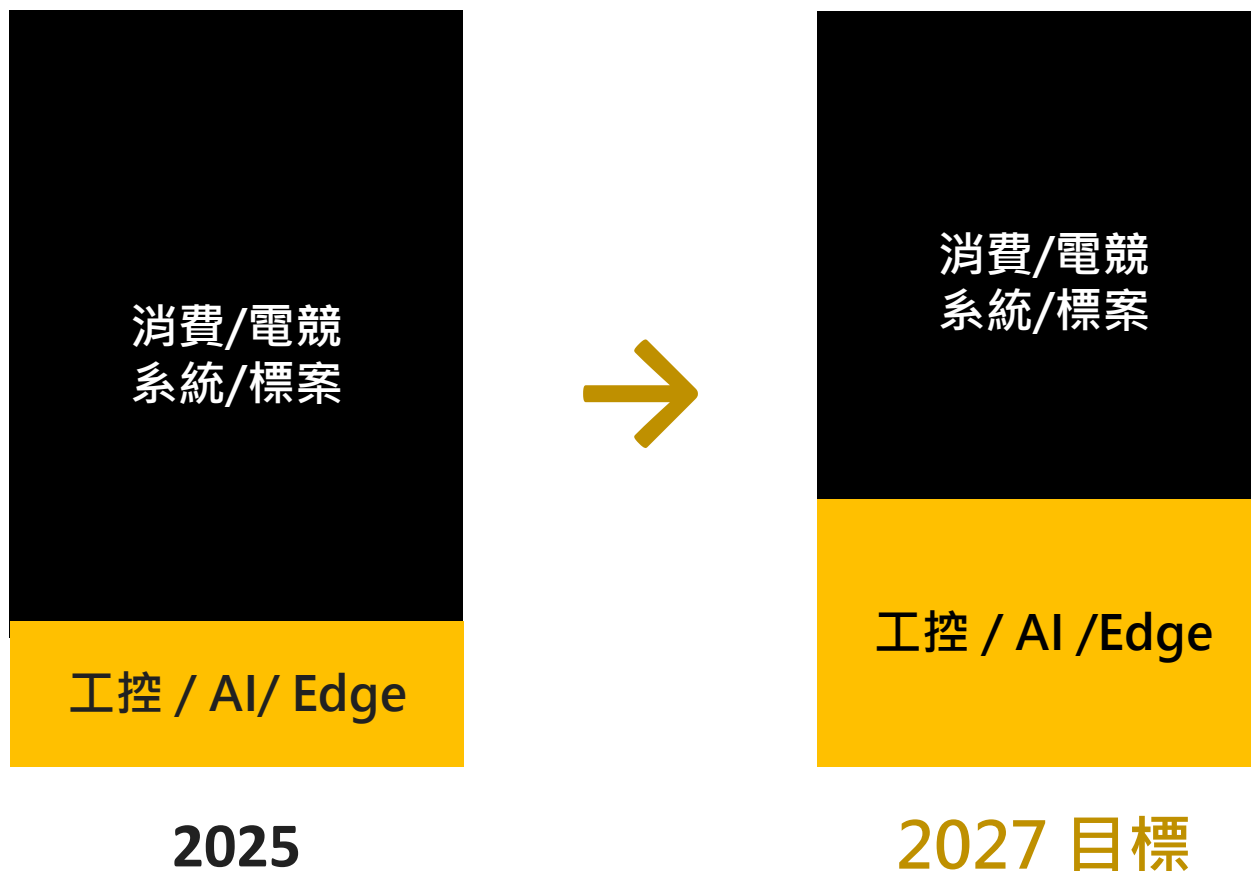
10年平均配發率

2015-2024

現金4.1 元
股票0.6 元

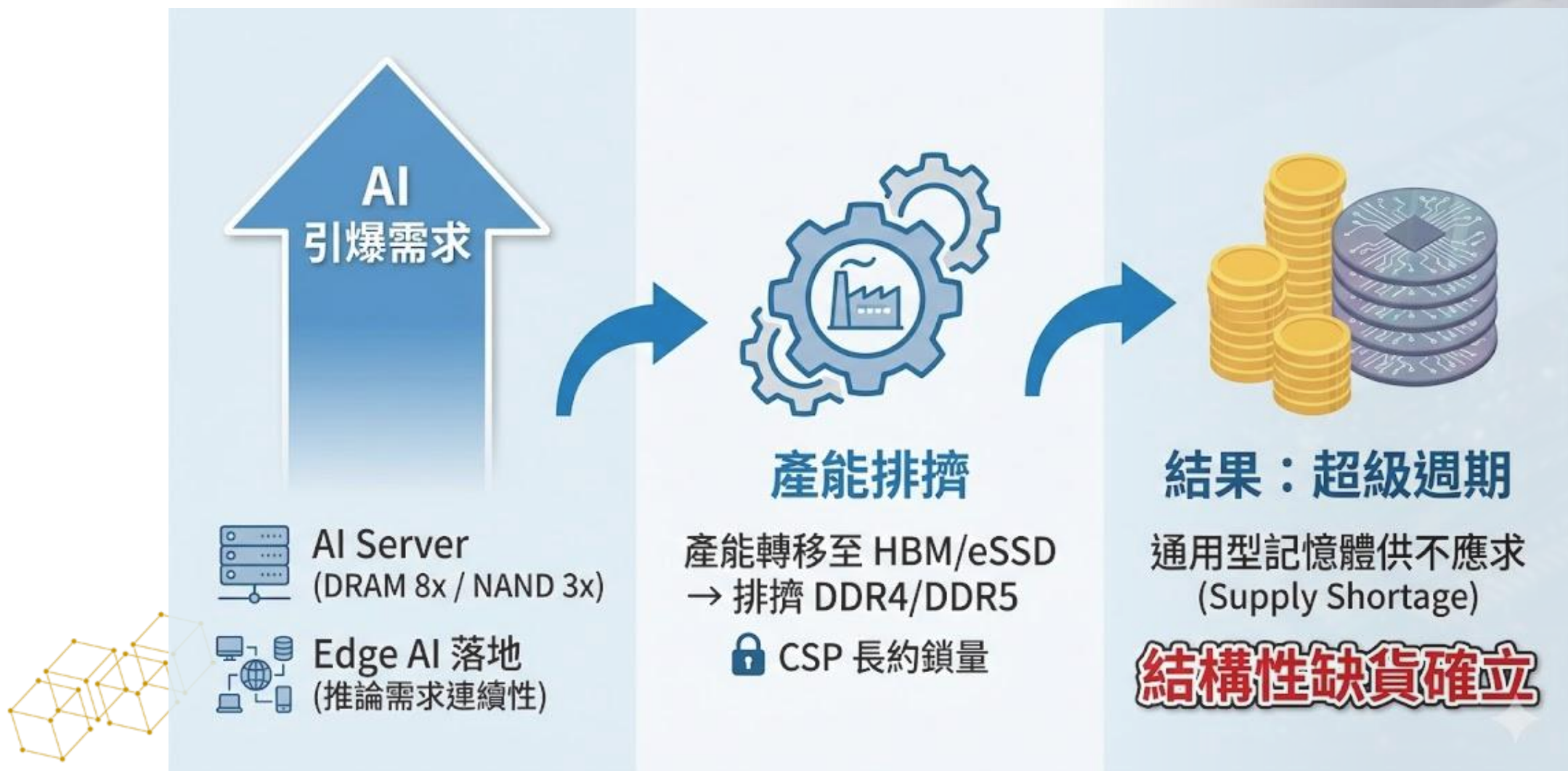
2025 股利配發

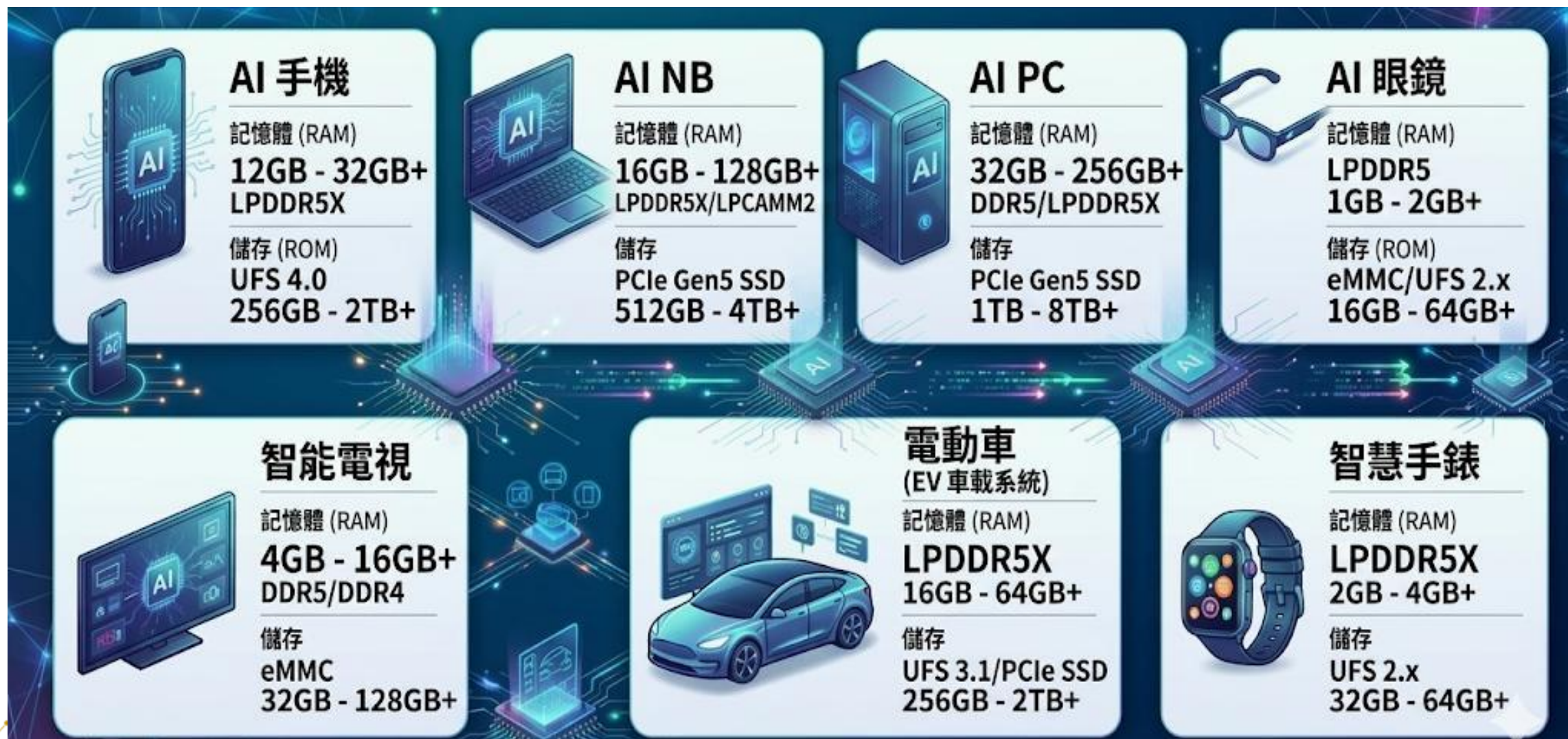
Cash Dividend



目標逐步提升高階工控、AI、Edge等高價值運算市場營收占比

AI 引爆「超級週期」





供給

供給受限（傳統產能大幅壓縮）

產能擠壓：三大廠優先供應 HBM

缺貨警訊：DDR5 缺至 2027、DDR4 產能遭遇排擠

2026 不確定因素：區域衝突、原廠政策、新技術導入

需求爆發（AI 驅動）

技術演進：AI Token 爆發持續推升記憶體頻寬需求

排擠效應：CSP 排擠非 AI 應用，NB / PC / 手機品牌普遍漲價

長線趨勢：邊緣 AI 裝置普及，工控與網通記憶體需求同步攀升

需求

核心策略

◆ 布局 DDR5 高階市場

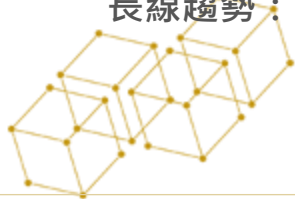
鎖定長期毛利優勢

◆ 優化產品組合

確保高利潤庫存水位

◆ 定位高價值應用

AI、IPC、Edge Computing



願景：為客戶提供一站式記憶體整合服務之領航者

goldkey

核心價值：

當責共好，追求卓越

誠信正直，永續環境與企業發展